



平成 21 年 12 月 2 日

各 位

会 社 名 株式会社東京カソード研究所
代表者名 代表取締役社長 大久保 尚武
(コード : 6 8 6 8 J A S D A Q)
問合せ先 執行役員管理本部長 川上 栄伸
電話番号 (03) 3962-8311

「事業再編計画（概要）」のお知らせ

当社は、今後の事業再編に伴う強固な収益体質の確立を目指し、平成 21 年 10 月 14 日付で公表いたしました「事業の合理化及び今後の計画に関するお知らせ」に記載のとおり、事業再編計画の概要を下記のとおりまとめましたので、お知らせいたします。

記

1. 事業再編の目的と背景

当社のこれまでの収益構造を検証すると、その時代の経済や暮らしに応じて、当社に利益をもたらす主役が代わってまいりました。

例えば国内・海外のテレビ普及率に呼応した CRT 用カソード部品、電気製品の高性能化を支える半導体の普及に伴うプローブカード、液晶製品の多様化に伴う各種検査装置や液晶バックライト用モリブデン電極など、シリコンサイクルやクリスタルサイクルといった業界特有の需給変動や IT バブルのような景気変動に影響されつつも、当社の原動力となって多くの利益を生み出してまいりました。

しかしながら、2008 年 10 月以降の金融市場の混乱に伴う景気変動は、生産構造の変化をもたらし、当社や電子・電気業界における経営環境を急速に変化させてしまいました。

この状況下において当社も昨年下半年以降の急速な環境変化の大きな渦に巻き込まれて、昨年度は大幅な営業損失を計上し、当期においても非常に厳しい状況に直面しております。

経営環境の変化は当期以降も進むものと予想され、当社が高い収益力を創出できる体質を再構築するためには、市場における当社の強みを改めて深く検証し現状に固執することなく、早期に事業の撤退を含めた事業構造の見直しが必要であるとの結論に至りました。

ここにおいて当社は、収益の改善が不透明な事業を見極め、今後早期に成長が見込まれる分野及び重点分野を明確化させ、それらに経営資源をシフトすること（事業再編による選択と集中）で、収益構造を変革させるとともに、損益分岐点を大幅に下げて将来へ向けた新たな成長軌道を早急に確立するために、事業再編を重要な経営課題といたしました。

2. 事業再編のポイントと諸施策

当社が行う再編は単なるコストの削減や対処療法的な事業廃止ではなく、成長分野への投資キャッシュを生むための筋肉質な体制を構築するための前向きな再編であることを念頭に置き慎重に協議いたしました。

事業環境の見通しや事業セグメントごとの投資効率、再編後の収益構造の観点から、独自技術により当社の強みが発揮でき、安定的に収益の確保が見込まれる事業と、早期の収益改善が困難な事業について、次のとおり再定義を行いました。

そして、安定的に収益の確保が見込まれる事業へ経営資源をシフトした上で、将来を担う成長事業の育成に取り組んでまいります。

その一方で早期の収益改善が困難な事業については、あらゆる選択肢を検討しつつ、迅速な対応を図ってまいります。

(1) 中核となる事業

プローブカード事業は、シリコンサイクルやクリスタルサイクルなどの景気に左右される事業であります。装置を主軸とする事業に比べて受注から代金の回収までの投資効率が良く、自社能力や将来における永続性が高い半消耗治具であることから、この「プローブカード事業」を中核に置くことといたしました。

■プローブカード事業のうち、①カンチレバー(*1)型

カンチレバー型のプローブカードは検査用治具として技術的な完成度が高く、成熟した分野と言われておりますが、針の素材や加工技術についてはまだ開発余地があります。当社は1970年のプローブカード製造及び販売開始以来、プローブカードのリーディングカンパニーとして確固たる地位を築いてまいりましたが、その根源となるものは当社の得意とする針素材の開発であります。

当社は創業時より、CRT用カソード部材を中心とした多くの素材技術や微細加工技術を有しており、プローブカードの針素材や加工技術においてもこの技術を活用し、他社への優位性を保ってまいりました。

当社はこの強みを活かし、新素材の開発や技術改良による新製品の開発に注力するとともに、取引先の視点により使い勝手とコストパフォーマンスを訴求した製品開発と迅速なサービスを推進するとともに、中核事業における本命として位置付けて、成長に必要な資源となる「主要な利益をもたらす事業」に変革させるため1、2年を目途に早急に収益の柱としての基盤作りに集中・特化するよう図ってまいります。

(2) 拡大事業

■プローブカード事業のうち、②垂直(*2)型

電気製品の高性能化は半導体産業を拡大させてきました。数量の増加はもちろん、大容量化、小型化に進化するため、半導体の用途に合わせて、シリコンウエハへの回路配置やマトリクス（格子状）配置が新たに形成され、これとともにプローブカードによる半導体検査の短時間化のために、複数個の回路を一括して検査するなどの方法も確立されました。

このためカンチレバー型プローブカードでは測定不可能なウエハを検査するために、垂直型プローブカードが生まれました。両者はそれぞれの弱点をカバーする補完関係にあり、対象となるデバイス

に対する検査コストや適性能力において明確な棲み分けが出来ております。

垂直型プローブカードは、カンチレバー型プローブカードによって収益の基礎をしっかりと確保した上で、中核となる事業と「同等以上」の収益をもたらす成長事業となるように、当社計画の第2段階として位置付けて、当社が得意とする微細加工や素材開発により製品の開発強化を行うとともに、新規取引先に対する拡販や、現時点でカンチレバー型プローブカードを販売する取引先へのアプローチにつなげられるように当社とのパートナーシップをより強固にする施策を行ってまいります。

■プローブカード事業のうち、③MEMS(*3)型

現在のプローブカードにおける最新のウエハ検査技術であり、取引先の高い要求を満たすことができるものに、MEMS型プローブカードと呼ばれる新型プローブカードがあります。日本国内の競合他社も製品化させておりますが、激しい競争の中、技術革新のスピードに対応し、長期にわたり多額の開発資金を投入する必要があります。

そこで当社は、まずカンチレバー型でしっかりとした収益基盤の確保を行います。

次に垂直型プローブカードの開発に集中します。

MEMS型プローブカードについては、3年から5年の中期的成長事業と捉えたうえで慎重に議論を重ね、その時点での目標を超える利益を達成している場合に他の二種類のプローブカードと相对比较し、開発に踏み切るかを判断いたします。

当社は、市場に初めてMEMS型プローブカードを投入した米国フォームファクター社（NASDAQ 上場）と一部製品について昨年より販売代理店契約を結んでおります。今般さらに、SOC(*4)用製品の販売、組立業務提携を結び関係を強化しましたので、既存顧客からの要請に対しては米国フォームファクター社の製品の提供により対応してまいります。（詳しくは平成20年11月17日付当社「米国フォームファクター社との代理店契約に関するお知らせ」及び平成21年12月2日付当社「米国フォームファクター社と業務提携に関するお知らせ」をご参照ください。）

今後も両社の良好な関係を強固にしつつ、顧客満足度の充実に努めてまいります。

(3) 撤退事業

今期中に収益改善の見込めない事業について、再編の選択と集中に伴い撤退いたします。

■ATE事業（装置）

当社は、当初装置事業として各種検査装置や測定装置を製品群として揃えており、取引先とともに作り上げてゆくビジネスモデルは取引先を始め大学や研究機関からも厚い信頼を得ておりました。しかしながら、売上に占めるリピート受注の割合を上げることができなかつたため汎用性の乏しい受注生産品として原価低減が進まず、想定した利益率の目標まで達成することができませんでした。

これらの課題に対応すべく、選択と集中により製品群を見直し、また資材調達等を整理し、利益の出る製品に特化したATE事業として平成20年4月より事業を展開してまいりました。

この中で液晶パネル用非接触オープンショート検査装置は取引先からの支持も大きく、利益を生み出す製品として確立することが出来ましたが、これからのビジネス展開や装置事業特有の資金負担を考慮すると、今後同事業の維持は非常に厳しいことが予想されました。

そこで事業の譲渡を含めてより良い方法を模索していたところ、同業の株式会社アドバネット様より打診があり、平成21年7月31日この事業を譲渡いたしました。

この事業譲渡により、特別利益が 300 百万円発生しております。

■O V I S 事業（装置）

この事業は、装置事業の分割により A T E 事業と同時に立ち上げた事業です。この事業が取り扱う各種画像処理関連検査装置は競合が少なく、顧客からのニーズも高いため、高単価での引き合いが見込まれておりましたが、取引先各社の大型設備投資に対する意欲は盛り上がり欠け、支払条件や納期延期といったことが繰り返し行われることも多く、製品化にいたるまでのコストを目標まで引き下げることができなかったことから、大幅な収益構造の悪化が顕在化しておりました。

現時点では、開発費の回収に至らない状況ではありますが、継続することは会社に更なる収益圧迫と資金の流出をもたらすおそれがあり、今年度中での撤退を決断いたしました。

■電子部品事業（半導体部品関連を除く）

昨年度まで当社事業の主力であり、その中心にある液晶テレビのバックライト用モリブデン電極は、液晶テレビの価格低下に加えて昨秋からの消費低迷によって市場在庫が急激に増加したため、低価格品のニッケル電極の更なる価格破壊をもたらし、結果として高付加価値モリブデン電極との価格差が開き、予算の大幅未達成となりました。さらにバックライトは、電極の品種による高付加価値化から、省エネと技術革新による高付加価値化に流れが変わり、冷陰極管から L E D（発光ダイオード）に一気になろうとしています。

当社は液晶テレビにおける冷陰極管市場、特にモリブデン電極を用いた冷陰極管の急速な市場縮小により、今後このビジネスにおける収益が立たないと判断し、先細りを続けるカソード部品や利益に結びつかない A B S も合わせたうえ、今年度をもって撤退することといたしました。

（4）機会事業

収益化が見込まれる限りは継続する事業です。

■電子部品事業（半導体部品関連のみ）

電子部品の中でも半導体の製造に関わる部門であり、半導体市場の需給に左右されますが、当面は収益貢献が見込まれるため、電子部品事業の中のこの分野についてのみ継続いたします。しかし中核の事業とはなり得ないため、環境の変化等により収益化が危ぶまれる兆候が明らかになった時点で、継続をするかどうかを含めて速やかな対応を検討する事業に位置付けます。

3. 事業再編から目標達成への道のり

- ① 中核事業の更なる絞込みと強化
- ② 主要な柱となる成長事業の構築
- ③ 売上拡大とコスト削減による損益分岐点改善

当社は、経営環境の不透明下においても着実に収益が望めるものとして、今期の予算実績乖離状況において唯一期首予想が達成見込みとなるプローブカード事業について、これを中核事業にふさわしいものとし、さらに選択と集中による絞込みと強化を進めることとします。このため、針素材や技術

対応などを通じたカンチレバー型プローブカードにおける既存取引のシェアアップを重点的に行います。

次に、次世代を担う垂直型プローブカードの開発により、新製品の本格投入を次年度より行います。また、現時点で市場に提供している当社の垂直型プローブカード（コブラプローブ）の販路に新垂直型プローブカードを重ねるだけでなく、これを拡大させるためにあらゆるニーズに的確な製品を提供できるよう市場調査と新規顧客獲得の情報収集を怠り無く進め、取引先との信頼構築に努めます。

MEMS型プローブカードについては、昨年度より販売代理店契約を結んでいる世界トップシェアの米国フォームファクター社製品の販売を強化するとともに社内のメンテナンス体制を整え、取引先の満足度を充実させるとともに、今後における同社とのいっそうの関係強化につなげることとします。

さらに、プローブカードのコスト削減強化のために、材料と生産性向上の両面から分析を行ったうえ、速やかにこれを実行します。

特にプローブカードの性能を左右する針素材の加工については、取引先と十分に協議を行い、コストを削減しながらも品質の向上を狙います。またその他の部材についても見直しの頻度を上げるとともに、一括購入によるコスト削減などを行います。

生産性の向上については、海外子会社の活用を強化します。現在国内子会社の6割程度と目される生産性を5年間で国内子会社の9割まで向上できるように技術指導の強化をはかり、現地従業員の教育を重点的に行います。また、針を加工する際の工程を一部機械化し、生産工程の省力化と短縮化を推進します。

今年度については、資産の処分や早期退職制度の実施により、一時的に損失計上額が増加いたしますが、期初事業別予算から乖離したものについて9割前後は撤退事業が占めており、今回の事業再編に伴い来期以降への影響を及ぼさなくなるため、中核事業への選択と集中を通し収益面での財政状況の健全化を総合的に実施して参ります。

これら売上拡大及びコスト削減の諸施策によって、本年度当初の連結損益分岐点売上高137億円を段階的に引下げ、4割前後の価格低下にも耐えられる事業構造を構築しながら連結損益分岐点売上高54億円を目指すとともに、利益の確保に貪欲に取り組みます。

当社といたしましては、経営の透明化とともに不退転の決意を持って抜本的な事業再編を通じた収益構造の変革に取り組んで行く所存でございますので、今後ともご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

以 上

◆文章中の注記-----

(*1)カンチレバー・・・プローブカードにおける探針の形状、接触面に対して水平、片持ち梁とも言う。

(*2)垂直・・・カンチレバーが接触面に水平であるのに対して、針が垂直に当たる。コブラは針の形から命名。

(*3)MEMS・・・微細加工技術を応用した最先端の針、Micro Electro Mechanical Systems の略称。

(*4)SOC・・・システム動作に必要な全ての機能の一つの半導体にした方式、System on a Chip の略称。